

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-006

| | |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：电话会议 |
| 参与单位名称 | 平安基金、中邮基金、大成基金、太平养老、平安资管、天风证券、国金证券、华创证券、中金公司 |
| 时间 | 2022年11月28日至12月1日 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书：张仕兵 董事会办公室主任：曹卉 证券事务代表：黄玉珊、刘懿瑶 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司简介：</p> <p>中科蓝讯是国内领先的集成电路设计企业之一，主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计和销售，主要产品包括 TWS 蓝牙耳机芯片、非 TWS 蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片等。</p> <p>公司是业内较早采用 RISC-V 指令集架构作为技术开发路线的芯片设计企业，基于开源的 RISC-V 指令集架构，配合开源实时操作系统 RT-Thread，自主开发出高性能 CPU 内核和 DSP 指令，实现了各种音频算法。目前公司产品已进入 TCL、传音、魅蓝、NOKIA、飞利浦、联想、铁三角、创维、纽曼、山水、惠威、摩托罗拉、喜马拉雅、倍思、boAt、科大讯飞、夏新、网易、唱吧、QCY、天猫精灵、魔声 Monster、Sudio 等终端品牌供应体系。</p> |

问答环节：

Q1：消费电子今年和明年行情如何？

从去年“亚马逊事件”至今，消费电子行业就一直处于去库存状态，目前蓝牙音频市场相对其他市场库存水平较低。近期中低阶产品的市场需求恢复较快，白牌市场的订单需求增速较高。9月开始是行业传统旺季，但自2021年下半年起，行业需求萎靡，今年同比去年虽有所增长，与真正的旺季相比仍有一定差距。目前公司在手订单及出货稳定，后续需结合行业政策、市场情况等判断行情变化。

Q2：公司经销商库存水平如何？

公司并非采用“订单式生产模式”即按订单需求生产产品，而是“备货式生产模式”，即公司结合市场需求预测、公司备货政策、客户需求情况及代工厂产能情况等制定生产计划，根据客户的订单可即时发货。因此经销商的库存水位较低，在节假日等特殊时间段会提前备货。

Q3：公司毛利率会继续下降吗？

前期受上游晶圆涨价、产品售价调整以保持市占率的影响，公司2022年前三季度毛利率有所下滑。结合目前上游晶圆及封测成本下降、市场需求恢复及公司新产品推出，公司未来毛利率有望上升：

1、公司对现有产品进行升级迭代，针对产品的性能方面、成本方面都做了大幅度的优化：减少单颗芯片晶圆面积，从而降低芯片单位成本，同时提升用户体验、产品功耗、信噪比等性能；

2、公司新推出的讯龙三代高阶产品毛利率在40%左右，可应用于蓝牙耳机、音箱、手表等产品，会成为公司未来的增量市场，提升公司在蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能穿戴产品在品牌领域的竞争力；

3、公司上游晶圆厂和封测厂的产能有所缓解，价格也有一定幅度的下调，公司单位采购成本逐渐降低。

Q4: 公司研发人员招聘情况及未来规划如何?

截至目前公司员工数量已超过 200 人, 2022 年通过社会及校园招聘共吸收 60-70 名研发人员, 2023 年计划继续通过社会及校园招聘吸收人才, 持续为服务品牌客户、满足募投项目需求做准备。

Q5: 请问公司未来产品布局情况如何?

针对中低阶产品, 公司将通过芯片设计改进、IP 晶圆面积优化等手段, 在稳步提升产品性能的同时, 减少单颗芯片晶圆面积, 从而降低芯片单位成本; 对于公司新推出的高端芯片产品讯龙三代, 采用 22nm 制程, 主要应用于高端蓝牙耳机、音箱、智能手表等, 性价比具有较强的市场竞争力, 会成为公司未来的增量市场, 提升公司盈利水平, 改善毛利率, 并有望在一线品牌市场做出突破。

同时, 公司重点布局的物联网芯片是我司募投项目之一, 主要用于智能家居等领域, 有助于公司抓住物联网产业快速发展的良好机遇。

Q6: 公司对募投资金的使用有什么规划吗?

公司本次募集资金投资项目将投向于智能蓝牙音频芯片升级项目、物联网芯片产品研发及产业化项目、Wi-Fi 蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目和发展与科技储备基金。募投项目围绕公司主营业务, 通过技术研发进一步提升产品性能、优化产品结构, 不断升级公司芯片工艺制程。将公司产品线扩充至 Wi-Fi 蓝牙一体化芯片、物联网芯片等新业务、新产品领域, 进一步增强公司技术研发实力, 提升核心竞争力, 实现可持续发展。基于对客户需求的调研、研发项目的排期及市场竞争情况, 公司将按照计划逐步推进募集资金投资项目。

Q7: 公司在拓展品牌客户时具有哪些竞争力?

公司自 2019 年起投入研发布局品牌市场, 2020 年推出讯龙一代产品开拓品牌市场, 后续推出的讯龙二代产品在一代的基础上工艺从 55nm 升级到 40nm, 对射频性能、内存及算力等做了升级, 满足更多品牌客户

的需求，有效拓展了更多的品牌客户。新推出的高端芯片产品讯龙三代采用台积电 22nm 制程，在性能等方面也对标了一线品牌客户的需求，性价比更具优势。公司使用 RISC-V 指令集架构作为技术开发路线研发、设计芯片，IP 自主可控，不断优化设计降低成本，在性价比方面具有较强竞争力。同时，公司始终紧贴市场，在积极顺应市场发展趋势及了解客户需求方面具有优势。

在接待过程中，我们严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等关于投资者关系活动的相关规定，与来访人员进行了充分的交流与沟通，并未出现未公开重大信息泄露等情况。